南通富士通微电子股份有限公司

证券代码:002156　证券简称:通富微电　公告编号:2012-011

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人石明达先生、主管会计工作负责人王宏宇女士及会计机构负责人(会计主管人员)王宏宇女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	通富微电
股票代码	002156
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王宏宇	丁燕
联系地址	江苏省南通市崇川路288号	江苏省南通市崇川路288号
电话	0513-85058919	0513-85058919
传真	0513-85058929	0513-85058929
电子信箱	nfme_stock@fujitsu-nt.com	nfme_stock@fujitsu-nt.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,622,046,684.09	1,727,112,896.76	-6.08%	1,237,931,217.65
营业利润(元)	11,829,124.67	112,276,500.68	-89.46%	71,578,334.48
利润总额(元)	61,191,746.25	157,387,940.59	-61.12%	73,994,173.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,028,221.73	139,078,880.99	-64.75%	60,228,718.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,179,794.15	110,441,055.57	-93.50%	67,219,838.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,939,203.15	579,600,373.15	-98.98%	217,287,754.95
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,390,223,114.94	3,634,209,945.48	-6.71%	2,095,725,175.73
负债总额(元)	1,209,641,154.71	1,501,902,973.93	-19.46%	1,030,048,497.87
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,180,581,960.23	2,132,306,971.55	2.26%	1,065,676,677.86
总股本(股)	649,866,720.00	406,166,700.00	60.00%	347,100,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.08	0.25	-68.00%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.25	-68.00%	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.20	-95.00%	0.19
加权平均净资产收益率(%)	2.27%	11.61%	-9.34%	5.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.33%	9.22%	-8.89%	6.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	1.43	-99.30%	0.63
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.36	5.25	-36.00%	3.07
资产负债率(%)	35.68%	41.33%	-5.65%	49.15%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	36,632.24	不适用	-4,094,206.20	-389,923.19
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,387,701.94	不适用	49,784,411.23	3,098,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	不适用	-11,393,410.00	-10,532,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,061,712.60	不适用	-578,765.12	-292,238.16
所得税影响额	-7,514,194.00	不适用	-5,080,204.49	1,125,641.41
合计	41,848,427.58	-	28,637,825.42	-6,991,119.94

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	43,281	本年度报告公布日前一个月末股东总数	40,613

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1.南通华达微电子集团有限公司	境内非国有法人	36.93%	239,990,400	0	32,530,000
2.富士通(中国)有限公司	境外法人	24.62%	159,993,600	0	0
3.中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	2.97%	19,270,000	0	0
4.全国社保基金四一零组合	其他	0.25%	1,597,342	0	0
5.中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.19%	1,252,765	0	0
6.申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.18%	1,157,256	0	0
7.周建辉	境内自然人	0.15%	985,700	0	0
8.胡玉花	境内自然人	0.11%	716,800	0	0
9.倪宁瘦	境内自然人	0.10%	634,700	0	0
10.虞锋	境内自然人	0.09%	600,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
1.南通华达微电子集团有限公司	239,990,400	人民币普通股
2.富士通(中国)有限公司	159,993,600	人民币普通股
3.中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	19,270,000	人民币普通股
4.全国社保基金四一零组合	1,597,342	人民币普通股
5.中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,252,765	人民币普通股
6.申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,157,256	人民币普通股
7.周建辉	985,700	人民币普通股
8.胡玉花	716,800	人民币普通股
9.倪宁瘦	634,700	人民币普通股
10.虞锋	600,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东和前10名无限售条件股东中:第1和第2名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)总体经营情况

2011年对公司来说是遭受前所未有困难和曲折的一年,日本地震、泰国水灾、欧债危机再加上半导体"硅周期"的影响所产生的叠加效应,牵制了整体经济环境的发展,使得公司未能像2010年那样实现高速增长。然而,在复杂形势下,公司上下团结一心、攻坚克难,采取切实措施,保持了公司生产经营的稳定,取得了来之不易的成绩。

在市场稳定方面:公司坚持以市场为中心,积极抢抓订单,努力保持生产线的稳定运行。在下半年全球范围半导体市场需求剧减的情况下,公司全年产量、销售收入下降不到一成。

在承担国家科技重大专项方面:公司"十一五"02专项目标基本完成;"十二五"02专项获得批准,首批中央财政拨款及省配套资金已经到位;设计与仿真平台初步建立;公司积极组织专利申报,2011年全年共申报专利102项;参与省科技厅《封装标准》制定,成为国家标准的主要起草单位之一。

在新产品、新工艺的开发、应用及量产方面:成功开发了降低BGA封装成本的新技术,BGA月产量一举突破600万块。成功开发高密度BUMP技术,成为国内唯一将BUMP技术成功应用于CPU、GPU等高端领域的封测企业;成功开发电镀再布线、液态树脂印刷等WLCSP技术新工艺,建成WLCSP产品生产线并生产出具有质量优势的产品;铜线键合技术能力大幅提高,低成本铜线产品占比达到25%以上。

在创新平台建设方面:公司与中科院上海微系统所共同组建江苏省企业院士工作站,与南通大学共建集成电路企业研究院,为公司先进封装技术的研发打造高层次创新平台。

在国际合作方面:公司与日本富士通的合作取得积极成果,被授予优秀供应商奖,收购的日本富士通LQFP和BUMP两条生产线于上半年实现了全面量产;与日本Teramikros(原卡西欧微电子)的WLP先进封装产品和技术合作也取得实质性进展。通过国际合作,仅用一年半时间公司的圆片级封装就达到了国际先进、国内领先的水平。

在人力资源建设方面:公司贯彻"精兵强政"理念,不断引进人才,2011年公司又有一人入围国家"千人计划"和南通市"江海英才计划";公司坚持以人为本,通富家园外来员工集体公寓改造、食堂扩建等员工生活设施相继完成并投入使用。

2011年,公司努力克服了半导体市场需求剧减、竞争激烈等不利因素的影响,全年销售收入同比略有下降。而由于原材料上涨、人工成本增加、人民币升值等因素的影响,导致利润下降明显。另外,公司承担了国家"十一五"02专项"极大规模集成电路制造装备及成套工艺"项目,项目的实施由国家专项资金支持,根据《企业会计准则》等有关规定,将公司的项目资金计入递延收益,根据项目进度,逐笔转入营业外收入,同时将项目实施过程中发生的直接费用和间接费用计入管理费用,从而增加了公司经营成本,减少了公司实际营业利润。

2011年各项经营指标如下:

单位:万元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	162,204.67	172,711.29	-6.08%	123,793.12
营业利润	1,182.91	11,227.65	-89.46%	7,157.83
利润总额	6,119.17	15,738.79	-61.12%	7,399.42
归属于上市公司股东的净利润	4,902.82	13,907.89	-64.75%	6,022.87

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

未来几年,若全球经济不出现大幅波动,平稳小幅的增长方式将是未来几年中国集成电路市场的发展趋势,市场未来几年的增速将保持在9%左右,市场发展的主要驱动力仍然主要来自PC、手机、液晶电视以及其它产量较大的电子产品。此外,未来新兴应用成为市场增长的推动因素之一,物联网、云计算、新能源、半导体照明、医疗电子和安防电子等新兴领域的发展,将为中国集成电路市场带来新动力,MID、便携式智能产品、智能仪表和能源控制等新产品对市场的影响力将逐渐增强,这些等新兴电子产品市场的发展也将在一定程度上推动半导体市场的发展。

同时,《集成电路产业"十二五"发展规划》(工信部规[2011]565号)的出台,作为行业发展的指导性文件,国家从战略层面重点支持集成电路产业持续快速健康发展,产业发展环境将进一步得到优化。

持续的产业政策导向,良好的产业发展背景,将对公司发展产生深远影响。公司通过积极承担国家科技重大专项,开展国际化合作,将紧跟全球集成电路封装测试技术发展趋势,公司正步入技术创新、科技成果产业化、产品结构优化的上升通道。

(二)公司面临的市场竞争格局及竞争优势

在市场竞争格局方面,集成电路封测产业基本保持了之前的态势,欧美日韩的大型IDM厂商以及中国台湾专业封测厂商依然占据着明显的优势。但同时,全球集成电路封测业务向中国大陆转移的趋势已确定无疑,而且转移速度正在逐渐加快。产业转移再加上政策扶持给中国大陆的封测企业提供了一个赶超世界一流半导体企业的绝佳机会。

随着行业越来越细分、技术进步加快、成本压力加大,集成电路封测企业的竞争格局已由过去的以质量和技术为主的竞争,演变为质量、技术、成本和服务的综合性竞争。

在上述竞争格局中,公司的优势主要有:

①融入国际高端产业链,公司创新能力不断得到提升的优势

面对低端市场竞争对手不断增多的形势,公司确立并实施了"全球化及大客户战略"。"全球化及大客户战略"就是要让国内外知名企业都成为我们的客户。大客户对产品技术、质量要求高,对公司无论在技术、管理各方面都是严峻的挑战。"全球化及大客户战略"的实施,使公司的封装水平在不断地适应和满足客户需求,促进了公司创新水平不断提高,从而使企业始终能够紧紧跟上世界集成电路封装行业发展的时代潮流。目前,德州仪器、意法半导体、富士通等世界排名前20位的半导体公司有半数以上与公司长期合作。国内许多优秀的设计公司也是公司的优质客户。

当前全球经济趋势必将加快全球集成电路市场中心由欧美日向国内转移。公司有对外合作的基础和优势,相信一定能抓住更多的机遇。

②积极承担国家科技重大专项,技术水平、产品结构不断得到优化的优势

高集成度、高附加值3D集成嵌入式封装成为未来市场发展重点。公司作为国家科技重大专项"02"专项的责任单位,重点开发的WLCSP、SiPBGA、BUMPING等产品和技术,以及今后着重开发的SiP等技术,市场前景非常广阔。2011年,BGA已经给公司创造了效益。2012年乃至今后几年,随着"02"专项产业化应用步伐的加快,公司新技术、新产品的应用将会给公司带来更大的效益。

③产业政策扶持的优势

国家政策鼓励做大做强骨干企业。国家《集成电路产业"十二五"发展规划》已经颁布,作为国家重点集成电路企业和国家科技重大专项承担单位,公司将有望得到国家产业政策更多的扶持。

(三)公司未来发展战略

1.公司发展战略

本公司坚持"服务与创新、进取与和谐"的经营理念,贯彻"顾客满意第一"的经营宗旨,为客户提供"一站式解决方案"。坚持主业发展的指导方针,奉行稳健、务实的经营风格,倡导科技创新和个性化服务,使公司在市场开发、技术创新、内部管理和资本运作方面均衡发展;坚持以人为本,尊重每一个员工的创造性和个性化,通过机制安排、制度建设、环境创造激发每一个员工的积极性;注重企业的社会责任,以信誉立身,公司经营成果分享于顾客、员工、股东与社会之间,追求公司股东、债权人、客户、员工的和谐价值实现,努力使公司成为"中国第一、世界一流"的集成电路封装测试企业,成为世界集成电路行业高端领域专业的封装测试服务提供商,力争早日进入全球封测行业前十强,并且努力使排名不断向前。

2.公司2012年度经营目标

2012年度生产经营目标为全年实现营业收入18.81亿元。生产经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、公司经营等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

(四)2012年工作思路及工作重点

2012年,公司将抓住行业及市场发展的机遇,迅速重建和放大公司的竞争优势,在保持企业稳健运行的前提下,实现规模效益的增长。2012年公司将重点做好以下工作:

1、加大市场开发力度,做好市场与产品结构调整。

美国与亚太区半导体市场2011年销售额呈现成长,其中亚太区是2011年度销售额最高的市场,达到1640.3亿美元,较2010年增长2.5%。公司保持与欧美市场深入合作的同时,将亚太市场作为未来几年的重点市场,进一步增加日本、台湾、中国内地市场的收入占比。

进一步优化产品结构,BGA、LQFP、QFN、Power和WLP是公司未来几年发展的重点产品,将进一步提高其销售占比。

2、加快"02"专项实施步伐,加大新品研发、推进力度,重点要做好10多个重点产品、车载品、铜线产品的量产推进工作以及项目产品的量产工作。

3、加大技术降本、管理降本推进力度,提高产品竞争能力。

通过针对产品和针对专项材料替代的两种途径相结合方式,进行成本结构分析,通过材料的低价替代、效率的提升、新技术的运用等制定成本改善方案,努力实现公司效益最大化。

4、进一步调整内部组织架构,优化再造生产运营模式,加大人才培养和引进,从而提高公司对于市场技术等外部环境的反应速度,培养一批更为专业的技术工艺人员,确保公司规模化量产,提供良好的、全方位的配套服务。

(五)为实现公司发展战略的资金需求及使用计划

为保证公司当前业务所需,实现2012年度的经营目标,完成在建投资项目,并为2013年的生产经营做适当准备,公司计划2012年内在生产设备、基础设施建设和动力供应上投资约2.89亿元。

2010年公开增发A股后,公司今后2至3年的发展资金已得到了基本保证。同时,公司将继续维护好银企关系,确保在需要银行信贷资金时,能够快速得到银行贷款。

(六)风险因素以及应对措施

1.黄金等原材料价格高位运行的风险

金丝为公司生产经营的重要原材料,而2011年金丝材料黄金的价格走势上延续了2008年全球金融危机以来的上行趋势,从年初的1307.95美元/盎司一路上升,于9月6日创出历史新高1920.78美元/盎司,之后虽有所回落,但仍在高位运行。公司为应对黄金价格高位运行对公司盈利的不利影响将采取如下主要措施:

第一,继续大力发展铜线产品。由于铜线成本只有金丝成本的5-10%左右,而且铜线替代金丝的技术及工艺已日趋成熟,具备大规模、产业化生产的条件,可以大面积推广。这是应对黄金涨价最直接、最有效的措施。

第二,不断改进生产技术和工艺水平。在保证产品质量前提下,利用直径小的金丝代替直径大的金丝或者以铜、铝等原材料代替金丝等方式,以降低公司产品成本。

第三,积极调整集成电路封装测试产品结构,提高高附加值产品的占比;同时,公司已与部分客户约定产品价格与黄金价格挂钩,由客户与公司一起承担黄金涨价的成本压力,以保障公司的总体盈利水平。

2. 劳动力成本持续上升的风险

近些年,制造型企业的劳动力成本处于持续上升的趋势并且这种状态在中长期内还将延续。公司作为大型制造型企业,劳动力成本占据总成本的相当大比重,劳动力成本的持续上升将直接影响公司的盈利空间。为应对该风险,公司将采取如下主要措施:

第一、优化组织结构,合理定岗定编,控制劳动力的投入,优化生产运营模式,培养一批更为专业的技术工艺人员,对富余人员组织学习文化和进行职业技能培训,充分发掘内部潜力,提高生产经营效率。

第二、发挥工资激励作用,建立激励导向的考核体系,按各岗位职责建立规范的绩效考核标准,奖惩结合,在主要工作基础上,更多考虑为公司带来价值的创造性项目。

第三,规范劳动力成本结构,在遵守国家规定的标准的基础上,适当提高劳动力成本结构中职工教育经费所占的比重,提高职工素质,着眼于公司人力资源开发和企业的长远发展。

3.新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险

今后几年,是公司产品结构和客户结构优化的关键时期。产品和客户优化的关键是公司研发的新技术、新工艺、新产品能否得到客户的认可,能否如期顺利进行产业化生产。如果这个过程中出现一些波折或反复,将给公司生产经营造成不利影响。为应对该风险,公司将采取如下主要措施:

第一、充实研发力量,加大研发投入,利用公司承担"02"专项的契机,引进高层次研发人才,主攻技术含量高、市场需求大的新产品开发。在技术研发层面上少走弯路,形成成熟且可以产业化的技术。

第二、积极配合客户对新技术、新工艺、新产品的认证,缩短客户认证时间,以达到新产品尽快量产的目的。

第三、公司核心的技术骨干和管理力量将优先服务于新技术、新工艺、新产品,举全公司之力,确保新产品如期产业化生产。

(七)并购重组进展情况

报告期内,公司未发生并购重组、重大资产重组等重大事项。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	162,204.67	139,698.33	13.88%	-6.08%	-2.44%	-3.22%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集成电路封装测试	160,308.32	139,692.94	12.86%	-6.92%	-2.41%	-4.03%
其它	1,896.35	5.39	99.72%	298.06%	-87.15%	8.53%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润4,902.82万元,较上年同期下降64.75%,与净利润有关的主要项目变动情况如下:

1.主营业务分行业、产品、地区经营情况分析

①主营业务分行业、产品情况

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	162,204.67	139,698.33	13.88%	-6.08%	-2.44%	-3.22%
主营业务分产品情况						
集成电路封装测试	160,308.32	139,692.94	12.86%	-6.92%	-2.41%	-4.03%
其它	1,896.35	5.39	99.72%	298.06%	-87.15%	8.53%

分析:从上表可以看出,公司主营业务非常突出,公司99%以上的营业收入来自于集成电路封装测试。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

②主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	55,887.55	22.20%
出口	104,420.77	-17.45%

分析:这几年,中国半导体市场一直呈现增长态势,发展环境良好。2011年,公司在保持与欧美市场深入合作的同时,重点开发国内市场,在全球范围半导体市场需求下降的情况下,2011年境内营业收入较上年同期增长22%,成效明显。

2. 订单获取和执行情况

公司主要从事集成电路的封装与测试业务,按照集成电路封测行业的一般商业规则,通常情况下,公司与客户签订《封装测试框架协议》,然后再根据客户提供的周订单或月度订单组织生产,为"以订单确定生产"模式。公司客户优势明显,客户资源较为稳定,且客户群在不断扩大,订单执行情况良好。

3. 产品销售和积压情况

由于公司为"以订单确定生产"模式,而且集成电路封测行业对于加工的产品一般都具有严格的交货期要求。因此,公司产品销售情况良好,产品库存保持正常、合理水平,不存在因滞销引起的库存积压情况。

4. 毛利率变动情况

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
销售毛利率	13.88%	17.10%	-3.22%	17.07%

报告期公司销售毛利率较2010年下降了3.22个百分点,主要原因是报告期内原材料价格的高位运行、人工成本的增加,给公司成本运营带来了较大压力。

5. 销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况

单位:元

项目	2011年	占2011年营业收入比例(%)	2010年	同比增减(%)	2009年
销售费用	9,149,079.50	0.56%	6,697,588.03	36.60%	6,314,748.84
管理费用	180,664,798.38	11.14%	139,949,166.86	29.09%	87,806,697.15
财务费用	21,918,896.62	1.35%	43,826,034.23	-49.99%	28,337,859.20
所得税	12,163,524.52	0.75%	18,309,059.60	-33.57%	13,765,454.62
合计	223,896,299.02	13.80%	208,781,848.72	7.24%	136,224,759.81

各项目增减幅度超过20%的原因:

①销售费用同比增长36.60%,主要是公司加大市场开拓力度所致。

②管理费用同比增长29.09%,主要是报告期内实施国家科技重大专项所致。

③财务费用同比减少49.99%,主要是报告期内利息收入增加所致。

④所得税同比减少33.57%,主要是报告期内公司利润总额同比大幅减少所致。

6. 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位:元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
一、经营活动产生的现金净流量	5,939,203.15	579,600,373.15	-98.98%	217,287,754.95
经营活动现金流入小计	1,758,134,261.65	1,933,564,580.02	-9.07%	1,076,352,780.73
经营活动现金流出小计	1,752,195,058.50	1,353,964,206.87	29.41%	859,065,025.78
二、投资活动产生的现金净流量	-645,343,386.75	-545,625,412.12	18.28%	-206,082,304.17
投资活动现金流入小计	68,746,601.82	35,655,796.57	92.81%	104,510,970.00
投资活动现金流出小计	714,089,988.57	581,281,208.69	22.85%	310,593,274.17
三、筹资活动产生的现金净流量	-39,826,238.38	1,013,990,828.38	-103.93%	12,469,935.22
筹资活动现金流入小计	794,102,531.38	1,545,240,392.00	-48.61%	474,578,700.00
筹资活动现金流出小计	833,928,769.76	531,249,563.62	56.97%	462,108,764.78

经营活动产生的现金净流量同比下降,主要是报告期内受信贷政策及外部环境的影响,公司根据实际情况,适当加快货款支付,以降低供应商原材料涨价压力,致使当年经营性现金流净额同比下降较多;投资活动产生的现金净流量同比增加,主要是公司报告期内募集资金项目投资所致;筹资活动产生的现金净流量同比大幅下降,主要是上一会计年度,公司成功实施公开增发A股、募集约9.62亿元资金。

7. 公司资产情况

单位:元

项目	2011年末		2010年末		本年比上年增减(%)
	金额	占总资产的比例(%)	金额	占总资产的比例(%)	
应收账款	227,174,160.21	6.70%	276,563,182.77	7.61%	-17.86%
存货	221,591,977.39	6.54%	199,010,450.05	5.48%	11.35%
固定资产	1,524,176,382.58	44.96%	1,343,133,130.05	36.96%	13.48%
在建工程	439,760,314.71	12.97%	175,482,975.58	4.83%	150.60%
无形资产	37,483,951.14	1.11%	28,561,249.05	0.79%	31.24%

各项目增减幅度超过20%的原因:

①在建工程同比增加150.60%,主要是报告期内公司实施募集资金项目所致。

②无形资产同比增加31.24%,主要是报告期内公司引进了Bump、WLP技术许可权等所致。

报告期内,公司主要资产采用的计量属性:会计核算以权责发生制为基础,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

8. 债权债务变动情况

单位:元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
应收账款	227,174,160.21	276,563,182.77	-17.86%	260,420,720.57
应付账款	309,615,683.89	407,257,696.74	-23.98%	241,674,603.51
短期借款	260,703,059.85	222,519,950.00	17.16%	224,898,000.00
长期借款	179,000,000.00	140,000,000.00	27.86%	245,000,000.00

各项目增减幅度超过20%的原因:

①应付账款同比减少23.98%,主要是报告期内受信贷政策及外部环境的影响,公司根据实际情况,适当加快货款支付,以降低供应商原材料涨价压力。

②长期借款同比增加27.86%,主要是公司调整借款结构所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

JCtech株式会社(日本精诚技术株式会社)本期不再纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比下降50%以上			
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	60.00%	~~	90.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	19,191,640.00		
业绩变动的原因说明	2011年第一季度延续了2010年的高增长,实现盈利1,919.16万元。但受国际经济形势影响,半导体行业需求有所下降,尤其是4季度需求下降明显,至2012年1月份达到最低谷。虽然3月份需求有所回暖,但受春节长假因素影响,1月份、2月份有效工作时间较短,一季度业绩较去年同期下降明显。			

南通富士通微电子股份有限公司

董事长:石明达

2012年3月30日

证券代码:002156　证券简称:通富微电　公告编号:2012-006

南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通富士通微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议,于2012年3月19日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知,并于2012年3月30日在南通文峰饭店召开,会议由公司董事长石明达先生主持。本次董事会应到董事10名,实到董事9名。严晓建董事因工作原因无法亲自出席会议,对于本次董事会议案,他委托刘剑文董事参加会议并行使表决权利。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式形成如下决议:

一、审议通过了《2011年度总经理工作报告》

表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。

二、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

截至2011年12月31日,公司资产总额为3,390,223,114.94元人民币,负债总额为1,209,641,154.71元人民币,股东权益总额为2,180,581,960.23元人民币;2011年,公司实现营业收入1,622,046,684.09元人民币,实现利润总额61,191,746.25元人民币,实现净利润49,028,221.73元人民币。

表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。

三、审议通过了《公司2012年度经营目标和投资计划》

公司计划2012年实现营业收入18.81亿元,较2011年实绩增长15.97%。

下表中是2012年计划营业收入与2011年实际营业收入的对比情况:

单位:人民币/亿元

2012年计划营业收入	2011年实际营业收入	增减变动百分比
18.81	16.22	15.97%

上述经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营层的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

为实现上述经营目标,并为2013年的生产经营做适当准备,公司计划2012年内在生产设备、基础设施建设和动力供应上投资约2.89亿元。

表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。

四、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

(一)公司2011年度利润分配预案

经审计,2011年度母公司单独实现净利润42,752,794.36元,根据《公司章程》的规定按10%的比例提取法定盈余公积金4,275,279.44元,加上年初未分配利润320,623,524.95元,可供股东分配的利润为359,101,039.87元。

2011年度,公司不进行现金利润分配,同时也不送股或公积金转增股本。

(二)2011年盈利但未提出现金利润分配预案的原因以及公司未分配利润的用途和使用计划

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为了保障公司的持续发展和股东的长远利益,结合目前的生产经营实际需要,公司拟2011年度不进行现金利润分配同时也不送股或公积金转增股本。未分配的留存资金,将全部用于实施发展战略及留存公司作为运营资金,用于公司持续发展,在以后年度回报投资者。	补充公司营运资金。

表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。

五、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司2012-008号公告。

表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。

六、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司2012-009号公告。

表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。

七、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。

八、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》

具体内容详见公司2012-010、2012-011号公告。

表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。

九、审议通过了《关于公司2012年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司2012-012号公告。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定,在审议公司与南通华达微电子集团有限公司及其关联方的关联交易时,与此有关联关系的董事石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生进行了回避,实际有表决权的票数为六票。

表决结果为:赞成票:六票;反对票:0票;弃权票:0票。

十、审议通过了《关于公司2012年与富士通(中国)有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司2012-012号公告。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定,在审议公司与富士通(中国)有限公司及其关联方的关联交易时,与此有关联关系的董事河野通有先生、福井明人先生进行了回避,实际有表决权的票数为八票。

表决结果为:赞成票:八票;反对票:0票;弃权票:0票。

十一、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

同意继续聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,聘期为一年。

表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。

十二、审议通过了《公司2012年与银行签署授信协议的议案》

根据2012年度生产经营的需要,公司在2012年内,计划与各银行合计签署32.5242亿元人民币的综合授信协议以及3,000万美元的综合授信协议。

以上数额为综合授信的最高限额,授权公司经营层在以上最高限额内,根据实际经营情况实施,并与各银行具体办理综合授信事宜。

表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。

十三、审议通过了《推荐董事候选人的议案》

由于柏木茂雄先生已辞去公司董事一职。董事会将推荐新的董事候选人。

同意推荐渡部潔先生为南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会新任董事候选人,任期至第四届董事会任期届满时止。同时在2011年度股东大会选举通过后,同意由渡部潔先生接替柏木茂雄先生担任副董事长、董事会战略委员会委员。

表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。

十四、审议通过了《聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

同意王宏宇女士辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。经公司董事会提名委员会、总经理石磊先生提名,聘任钱建中先生为公司副总经理。聘任章小平先生为公司财务总监;经公司董事会提名委员会、董事长石明达先生提名,聘任钱建中先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司2012-013号公告。

表决结果为:赞成票:十票;反对票:0票;弃权票:0票。

十五、审议通过了《修改公司章程的议案》

根据